

# 115學年度日間部碩士班\_半導體工程與材料系必修課程變動表

114_學年度科目	第_學年/學期	學分/時數	115_學年度科目	第_學年/學期	學分/時數	變動類別(停開、新增、更改課程名稱、學分)	修訂及重補修原則說明
專題討論	1/1	1/2	專題討論	1/1	2/2	學時一致	依據114學年度第1學期第2次院課程委員會決議調整
專題討論	1/2	1/2	專題討論	1/2	2/2	學時一致	
研究方法與論文寫作	1/2	1/2	研究方法與論文寫作	1/1	2/2	學時一致	

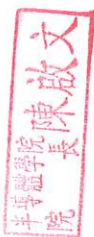


系課務委員簽章：

系主任簽章：



院長簽章：



115學年度課程規劃表

半導體工程與材料系

日間部碩士班

第一學年(115)						第二學年(116)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
院 必 修	專題討論	2	2	2	2	院 必 修					
	研究方法與論文寫作	2	2								
	小計	4	4	2	2		小計	0	0	0	0
專 業 必 修						專 業 必 修	論文	3	3	3	3
	小計	0	0	0	0		小計	3	3	3	3
專 業 選 修	高等物理冶金	3	3			專 業 選 修	半導體化學材料應用及檢 測	3	3		
	半導體元件導讀	3	3				奈米封裝技術	3	3		
	高等高分子化學	3	3				先進半導體技術	3	3		
	陶瓷材料特論			3	3		電子顯微鏡學			3	3
	薄膜工程導論			3	3		專利檢索與寫作			3	3
	電化學分析技術與應用			3	3		光譜分析			3	3

【科目類別】

專業科目：院必修、專業必修、專業選修

【科目類別】	學分	時數
院必修	6	6
專業必修	6	6
專業選修	18	18
合計	30	30

【注意事項】

- 1.最低畢業學分：30學分，其中專業選修18學分(本系至少12學分，其餘可跨系)。
- 2.每學期修習學分：下限為1學分。
- 3.「論文」必修6學分，俟口試通過後，一次給予6學分。
- 4.表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。
- 5.本表建立於115年3月18日

半導體工程與材料系 系主任 龍明有



半導體學院 院長 陳啟文

